

اثر فشار محفظه بر رشد لایه های نانو کامپوزیت مس-کربن تهیه شده با کاربرد همزمان
روشهای لایه نشانی RF-Sputtering و RF-PECVD

قدس الهی، طبیه^{۱,۲}؛ وساقی، محمد علی^{۱,۲}؛ شفیع خانی، عزیزاله^{۳,۴}؛ اولیایی، پروین^۴ و لامعی رشتی، محمد^۴

^۱دانشکده فیزیک دانشگاه شریف، تهران

^۲مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، تهران

^۳دانشگاه الزهرا، تهران

^۴پژوهشگاه علوم و تکنولوژی هسته ای، تهران

چکیده:

لایه های نانو کامپوزیت مس-کربن به روش همزمان RF-PECVD، RF-Sputtering از گاز استیلن و هدف مس رشد داده ایم. فرایند رشد در ناحیه ای که با تغییر فشار محفظه فرایند به کندوپاش فیزیکی در توان ثابت و فشار بحرانی ۱,۵ تا ۳ پاسکال تبدیل می شود، بررسی می شود. مقدار تخمینی انرژی متوسط یونها در این فشار بحرانی نزدیک به آستانه انرژی اسپاترینگ فیزیکی مس با یونهای استیلن است. با استفاده از این خاصیت و با تنظیم فشار اولیه از ۱,۳ تا ۶,۶ پاسکال لایه های نازک مس-کربن با محتویات مس متفاوت رشد داده ایم. محتویات مس این لایه ها با استفاده از پراکنده‌گر راترفورد (RBS) و اسپکتروسکوپی امواج ایکس (XPS) تعیین شد. تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و پراش امواج ایکس (XRD) بر تشكیل نانو ذرات مس دلالت دارند.

Effect of chamber pressure on the growth of nanoparticles copper-carbon composite films prepared by simultaneous use of RF-PECVD and RF-Sputtering deposition technique

Ghods Elahi, Tayebeh^{1,2}, Vesaghi, Mohamad Ali^{1,2}, Shafiekhani, Azizollah^{2,3} Oliaiy, Parvin⁴ and Lameii Rashti, Mohamad⁴

¹Physics Department Sharif University of Technology, Tehran,

²Institute for studies in theoretical physics and mathematics, Tehran

³Physics Department, Alzahra University, Tehran

⁴Nuclear Science Research School, Tehran

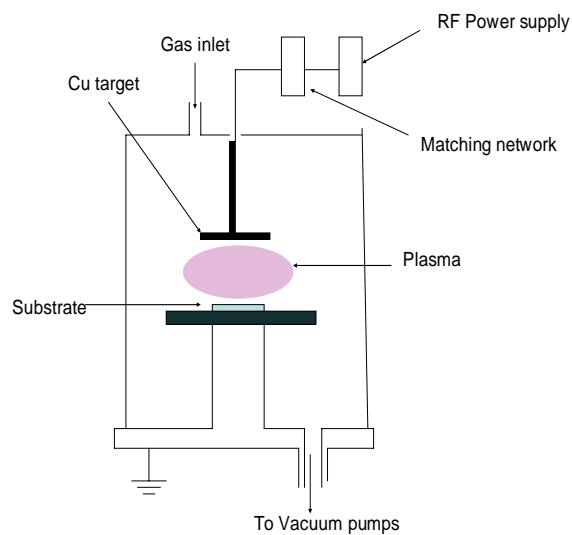
Abstract

Nanoparticle copper/carbon composite films were prepared by Co-deposition of RF-Sputtering and RF-PECVD method from acetylene gas and copper target. We investigate deposition process in the region where by changing pressure, the process converts to

physical sputtering mode in constant power regime and at a critical pressure between 1.5 to 3 Pa. The estimated value of mean ion energy at this critical point of pressure is close to threshold energy of physical sputtering of copper atoms by acetylene ions. By utilizing this property and by setting initial pressure from 1.3 to 6.6 Pa, nanoparticles copper/carbon composite films were grown with different copper content. The Copper content of our films was obtained by Rutherford Back Scattering (RBS) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). Atomic force microscopy (AFM) image and X-ray diffraction (XRD) indicated that copper nanoparticles were formed in our films.

مقدمه: در سالهای اخیر لایه های نازک نانو کامپزیتهای مس-کربن علاقه زیادی را به خود جلب کرده اند. این لایه ها پتانسیل کاربردی در میدانهای مختلف اپتیک، الکترونیک و بیولوژی دارند [1,2]. این لایه ها به روشهایی که بیشتر شیمی تر می باشد ساخته می شوند. روش تر محدودیت کار برداری در قطعات اپتیکی والکترونیکی لایه ها ایجاد می کند [3]. در این گزارش ما روش رشد همزمان RF-PECVD, RF-Sputtering که غیر شیمی تر است، معرفی می کنیم و همچنین فرایند رشد این روش را بررسی می نماییم.

آزمایش: لایه های نازک نانو کامپزیتهای مس-کربن با استفاده از یک دستگاه RF با فرکانس ۱۳,۵۶ مگا هرتز، از گاز استیلن و هدف مس ساخته شد. لایه نشانی روی شیشه و سیلیکن در دمای اتاق انجام شد. نمایی از محفظه در شکل ۱ نشان داده شده است.

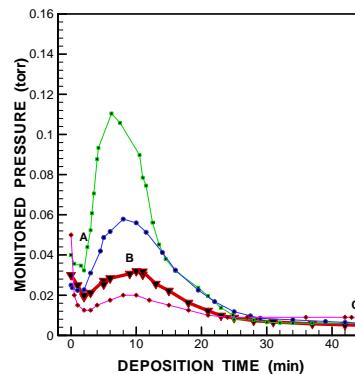


شکل ۱ : نمایی از محفظه لایه نشانی.

لایه نشانی در توان ثابت ۲۰۰ وات و فشار متغیر بین ۱,۳ تا ۶ پاسکال انجام شد. ضخامت لایه ها با استفاده از RBS step اندازه گیری شد که ۲۰ تا ۱۵۰ نانومتر بدست آمد. آنالیز RBS با استفاده از پروتونهای با انرژی ۱,۴ تا ۱,۸ مگا

الکترون ولت انجام شد. آنالیز XPS با استفاده از منبع آلمینیوم انجام گرفت. تصاویر AFM اندازه دانه ها را نشان می دهد و XRD تشکیل نانو ذرات مس را نتیجه می دهد.

نتایج و بحث: ما فرایند رشد این لایه ها بخصوص فرایند اسپاترینگ را بررسی می کنیم. در حین هر ساخت در توان ثابت، فشار محفظه خوانده می شود. تغییرات فشار بر حسب زمان برای چهار لایه نشانی با فشار اولیه متفاوت در شکل ۲ نشان داده شده است. در این شکل مشاهده می شود، برای هر لایه نشانی ابتدا فشار تا یک نقطه بحرانی بین ۱,۵ تا 3 پاسکال کاهش می یابد. سپس فشار تا یک مقدار بیشینه تقریبا هشت دقیقه افزایش می یابد. بعد فشار با نرخ کمتر کاهش می یابد. مهمترین کمیت برای توضیح فرایند ساخت و خصوصیت لایه های رشد یا فته انرژی متوسط یونهایی که به هدف برخورد می کنند، می باشد. توان RF به الکترود کوچکتر اعمال می شود. RF بین الکترود ها پلاسمای تولید می کند. حرکت بیشتر الکترونها نسبت به یونها سبب تراکم یونها در غلاف نزدیک الکترود ها می شود. یک ولتاژ منفی DC روی الکترود کوچکتر ایجاد می شود. ولتاژ RF بین غلاف دو الکترود به نسبت مساحت هایشان تقسیم می شود² $[4] V_1/V_2 = (A_2/A_1)^2$. الکترود کوچکتر نسبت به بزرگتر منفی می شود. این ولتاژ منفی به یونهای هیدروکربن مثبت به طرف هدف شتاب می دهد. یونها به نسبت λ/d پویش آزاد و d پهنای غلاف در عبور از غلاف انرژی از دست می دهند. پویش آزاد یونها در فشار $2,5\text{ پاسکال}$ 3 میلیمتر بدست آمد. پهنای غلاف از قانون لانگمیر $d=1.018 L(V/T)^{1/4}$ تقریبا 10 میلیمتر تخمین زده شد [5].

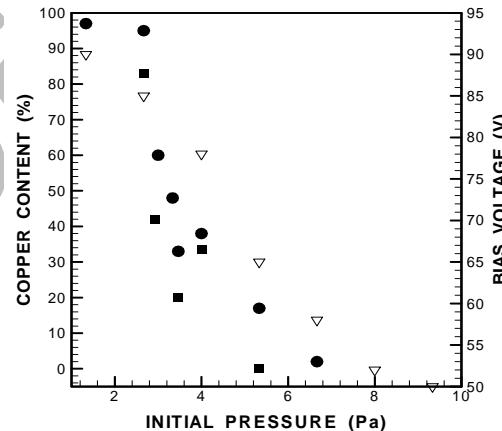


شکل ۲: تغییرات فشار محفظه حین لایه نشانی بر حسب زمان برای نمونه های با فشار اولیه متفاوت.

ما ولتاژ بایاس رادر فشارهای مختلف محفظه اندازه گرفتیم. ولتاژ بایاس بدست آمده با رابطه $V_b \sim W / P^{1/2}$ سازگار است. P فشار محفظه و W توان RF است. بر اساس توضیحات بالا میانگین انرژی یونها که به هدف برخورد می کنند در فشار $2,5\text{ پاسکال}$, 26 الکترون ولت بدست آمد. این عدد نزدیک به آستانه انرژی کندوپاش فیزیکی مس می باشد. آستانه انرژی کندوپاش فیزیکی از این رابطه بدست می آید [6].

$$E_{th} = E_s (M_1 + M_2)^4 / 4M_1 M_2 (M_1 - M_2)^2$$

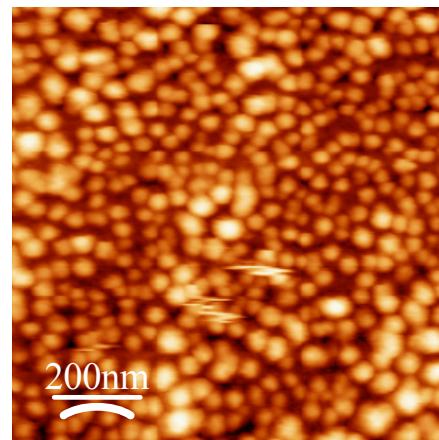
که E₀ انرژی پیوند سطحی هدف, M1 و M2 به ترتیب جرم یونهای فرویدی و اتمهای هدف می باشند. بر اساس رابطه بالا آستانه انرژی کندوپاش فیزیکی اتمهای مس با یونهای استیلن ۲۴ الکترون ولت بدست می آید. با استفاده از این نتایج و شکل ۲. ما می توانیم فرایند رشد و کندوپاش را توضیح دهیم. در شکل ۲. کاهش اولیه فشار به نرخ بالای نشت کربن مربوط می شود. در این شرایط همچنین یک کندو و پاش شیمیایی کم از اتمهای مس می توان داشت . نرخ انباست کربن از نرخ ورود گاز هیدروکربن به محفظه بیشتر است بنابر این فشار کاهش می یابد. وقتی فشار به ۲,۵ پاسکال می رسد، متوسط انرژی یونهای هیدرو کربن برای کندوپاش فیزیکی اتمهای مس مناسب می شود. اتمهای مس کنده شده فشار محفظه را افزایش می دهند. افزایش فشار ادامه می یابد تا دوباره انرژی متوسط یونها کمتر از آستانه انرژی کندوپاش فیزیکی شود. این نقطه، نقطه قطع کندو پاش فیزیکی می باشد. بنابراین فشار کاهش می یابد. اما هنوز نشست کربن و یک کندو و پاش شیمیایی کم از مس داریم. اثر فشار اولیه محفظه بر محتویات مس نمونه ها بررسی شد. محتویات مس نمونه ها بر حسب فشار اولیه محفظه در شکل ۳. آمده است.



شکل ۳: محتویات مس نمونه ها بر حسب فشار اولیه. نتایج RBS(دایره ها) و نتایج XPS(مربع ها). ولتاژ بایاس بر حسب فشار(مثلث ها)

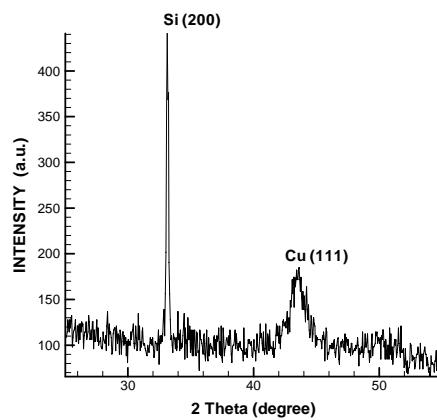
محتویات مس لایه ها زRBS و محتویات مس سطح لایه ها ز XPS بدست آمد. همچنین تغییرات ولتاژ بایاس اندازه گیری شده بر حسب فشار در این شکل آمده است. تغییرات محتویات مس بر حسب فشار اولیه و ولتاژ بایاس بر حسب فشار شبیه هم هستند. نرخ کندو پاش مناسب است با ولتاژ بایاس و ولتاژ بایاس نیز بطور معکوس با فشار مناسب می باشد. فشار اولیه محفظه اثر مهمی روی محتویات مس دارد. با استفاده از این خاصیت لایه هایی با درصد مس متفاوت و شامل نانو ذرات مس با اندازه های متفاوت ساخته شد. درصد مس این لایه ها ۰.۹۷٪ تا ۰.۲٪ از آنالیز RBS بدست آمد.

تصاویر AFM بر تشكیل نانو ذرات با قطر ۲۰ تا ۶۰ نانومتر دلالت دارد. شکل ۴. تصویر نو عی از این نمونه ها را نشان می دهد.



شکل ۴: تصویر AFM از نمونه شامل ۴۰٪ مس.

این نمونه شامل ۴۰٪ مس می باشد. همچنین نتایج XRD شاهد دیگری بر تشکیل نانو ذرات مس می باشد که نمونه نوعی آن در شکل ۵ آمده است. این نمونه شامل ۵۰٪ مس می باشد.



شکل ۵: پراش امواج ایکس از نمونه شامل ۵۰٪ مس.

نتیجه گیری: لایه های نانو کامپوزیت مس-کربن به روش رشد همزمان RF-PECVD, RF-Sputtering از گاز استیلن و هدف مس رشد داده ایم. فرایند رشد در ناحیه ای که با تغییر فشار محفظه فرایند به کندوپاش فیزیکی تبدیل می شود، بررسی شد. کاهش اولیه فشار محفظه به نرخ بیشتر انباست کربن نسبت به نرخ ورود گاز هیدروکربن مربوط میشود. وقتی فشار به ۲,۵ پاسکال می رسد، متوسط انرژی یونهای هیدروکربن برای کندوپاش فیزیکی اتمهای مس مناسب می شود. اتمهای مس کنده شده فشار محفظه را افزایش می دهند. افزایش فشار ادامه می یابد تا دوباره انرژی متوسط یونها کمتر از آستانه انرژی کندوپاش فیزیکی می شود. این نقطه، نقطه قطع کندوپاش فیزیکی می باشد. بنابراین فشار کاهش می یابد. با استفاده از این خاصیت و با تنظیم فشار اولیه از ۱,۳ تا ۶,۶ پاسکال لایه های نازک مس -کربن با محتویات مس متفاوت رشد داده ایم.

سپاسگزاری

از همکاری خانم واثقی نیا و آقای رفیعی صمیمانه تشکر می‌کنیم.

مراجع:

- [۱] L. Huang, H. Jiang, J. Zhang, Z. Zhang and P. Zhang, *Electrochemistry Communications*, 8(2006)262.
- [۲] S. Hussain, R.K. Roy and A. K. Pal, *J.Phys.D*, 38(2005)900.
- [۳] Yong Lei and Wai-Kin Chim, *J. AM. CHEM. SOC* **127**, (2005) 1487.
- [۴] J. Robertson, *Materials Science and Engineering*, R37(2002)129.
- [۵] M. Spolaore, V. Antoni, M. Bagatin, A. Buffa, R. Cavazzana, D. Desideri, E. Martines, N.Pomaro, G.Serianni and L. Tramontin, *Surface and Coatings Technology*, 116 (1999)1083.
- [۶] J. Roth, *Nuclear Fusion Research*, R.E.H. Clark, D.H. Reiter(Eds.), *springer* (2005), p204.